

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站刊發的《2024年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》，僅供參閱。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零二四年八月二十九日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事：

葉峻

孫國棟

周利民

熊承艷

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壩太平紳士

封松林

A 股代码：688347
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司
港股简称：华虹半导体

公告编号：2024-024

华虹半导体有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 6 日出具的《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,775.00 万股，每股发行价格为人民币 52.00 元，募集资金总额为 2,120,300.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 28,232.30 万元（含税）后，募集资金净额为 2,092,067.70 万元，上述资金于 2023 年 7 月 31 日已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“安永华明（2023）验字第 60985153_B02 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
实际收到的募集资金金额	2,094,241.40
减：支付发行费用	1,226.97
减：募投项目累计支出金额	433,152.37
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	15,768.01
期末募集资金专户余额	1,675,630.06

注：上表明细金额以四舍五入的方式保留两位小数；总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金管理协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。2023年7月，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。2023年9月，公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司、国泰君安、海通证券分别同招商银行股份有限公司上海分行、国家开发银行上海分行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、中国工商银行股份有限公司上海浦东分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》。公司与华虹半导体制造（无锡）有限公司、国泰君安、海通证券分别同中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》。公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司、华虹半导体制造（无锡）有限公司、国泰君安、海通证券分别同国家开发银行江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储六方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	存款方式	金额（人民币万元）
招商银行股份有限公司 上海分行	NRA999017055210902	活期存款及 协定存款	306,413.98
招商银行股份有限公司 上海分行	121911282310518	活期存款及 协定存款	7,613.86

国家开发银行上海分行	31000109000000100092	活期存款及 协定存款	1,916.49
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609999988	活期存款及 协定存款	190,252.10
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行营业部	1001280929300150002	活期存款及 协定存款	208,367.82
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609999998	活期存款	2.80
国家开发银行江苏省分行	32100109000000000037	活期存款及 协定存款	319,677.30
交通银行股份有限公司无锡分行	322000600013001312349	活期存款及 协定存款	298,984.62
中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050161543609988888	活期存款及 协定存款	144,703.70
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040259401	活期存款及 协定存款	197,697.38
合计			1,675,630.06

注：上表明细金额以四舍五入的方式保留两位小数；总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司董事会于 2023 年 8 月 23 日通过了《关于授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将总额不超过人民币 210 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。截至 2024 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金现金管理的余额为 1,675,297.27 万元，投资产品均为协定存款。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

根据公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在募投项目实施期间，通过银行电汇、信用证等结算方式，以自有资金支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额支付，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2024年8月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

单位：人民币万元

募集资金净额				2,092,067.70		本年度投入募集资金总额						238,719.53	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						433,152.37	
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
华虹制造（无锡）项目	否	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	201,608.59	279,442.60	-970,557.40	22.36	不适用	不适用	不适用	否	
8 英寸厂优化升级项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	7,387.20	10,813.93	-189,186.07	5.41	不适用	不适用	不适用	否	
特色工艺技术创新研发项目	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00	29,723.74	42,853.30	-207,146.70	17.14	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,042.54	42.54	100.04	不适用	不适用	不适用	否	
超额募集资金	否	-	292,067.70	292,067.70	-	-	-292,067.70	-	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	1,800,000.00	2,092,067.70	2,092,067.70	238,719.53	433,152.37	-1,658,915.33	20.70	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司董事会于 2023 年 8 月 23 日通过了《关于授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将总额不超过人民币 210 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。截至 2024 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金现金管理的余额为 1,675,297.27 万元，投资产品均为协定存款。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				详见本报告三（八）募集资金使用的其他情况									

注1：补充流动资金截止报告期末累计投入金额超出该募集资金总额42.54万元，系募集资金专户产生的利息。